

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：01347

新聞稿

華虹半導體二零二三年第二季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2023年8月10日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：01347；上交所科创板證券代碼：688347）（「本公司」）於今日公佈截至二零二三年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零二三年第二季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入達 6.314 億美元，同比上升 1.7%，環比持平。
- 毛利率 27.7%，同比下降 5.9 個百分點，環比下降 4.4 個百分點。
- 期內溢利 780 萬美元，上年同期為 5,320 萬美元，上季度為 1.409 億美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 7,850 萬美元，上年同期為 8,390 萬美元，上季度為 1.522 億美元。
- 基本每股盈利 0.060 美元，上年同期為 0.064 美元，上季度為 0.116 美元。
- 淨資產收益率（年化）10.0%，上年同期為 11.5%，上季度為 19.6%。

二零二三年第三季度指引

- 我們預計銷售收入約在 5.6 億美元至 6.0 億美元之間。
- 我們預計毛利率約在 16%至 18%之間。

總裁致辭

公司總裁兼執行董事唐均君先生對二零二三年第二季度業績評論道：

“儘管半導體市場尚未走出下行週期，華虹半導體在二零二三年第二季度仍然迎難而上，交出了一份令人滿意的成績單。截至第二季度末，公司折合八英寸月產能增加到了**34.7**萬片。得益於公司在多元化特色工藝平臺上的技術水準和業務規模的優勢，公司的四條生產線保持滿載運營。本季度，公司營收為**6.314**億美元，同比上升**1.7%**，環比持平；毛利率為**27.7%**，高於上季度給出的指引，同比下降**5.9**個百分點，環比下降**4.4**個百分點，主要受折舊和動力成本上升、以及平均銷售價格下調的影響。”

唐總繼續講道：“二零二三年八月七日，華虹半導體首次公開發行**A**股並在科創板上市，募集資金超過人民幣兩百億元，體現了廣大投資人對公司的認可和支持，對公司後續的加速成長將起到強力助推作用。作為全球領先的特色工藝晶圓代工企業，公司將持續優化特色工藝技術，進一步夯實特色工藝晶圓代工龍頭地位，以更出色的業績回饋投資人。”

電話會議公告

- 日期 2023 年 8 月 10 日（星期四）
- 時間： 17:00 香港/上海時間
05:00 美國東部時間
- 發言人： 唐均君，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官
- 廣播： 會議將在 http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php 或
<https://edge.media-server.com/mmc/p/xt2h7nk5> 作線上直播
(請提前註冊登記)
- 電話直撥： 請在會議前使用以下鏈接先進行註冊。註冊後，您將收到確認郵件獲得撥入號碼及個人 PIN。

<https://register.vevent.com/register/BI2d5948dcd4c3466bac73a8f562322cea>
- 重要提示：** 在會議開始前，您需要使用確認郵件中提供的個人 PIN 才能進入會議。請在註冊後，注意查收並保存確認郵件。出於安全原因，請不要與任何人共享您的 PIN。
- 網上重播： 直播約 12 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。

http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（A 股簡稱：華虹公司，688347；港股簡稱：華虹半導體，01347）（“本公司”）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先進“特色 IC + Power Discrete”的發展戰略，為客戶提供多元化的晶圓代工及配套服務。本公司專注於嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯與射頻等“8 英寸 + 12 英寸”特色工藝技術的持續創新，有力支持新能源汽車、綠色能源、物聯網等新興領域應用，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是中國擁有“8 英寸 + 12 英寸”先進集成電路製造主流工藝技術的產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約 18 萬片。另在無錫高新技術產業開發區內建有一座月產能 7.5 萬片的 12 英寸晶圓廠（華虹七廠），這不僅是全球領先的 12 英寸特色工藝生產線，也是全球第一條 12 英寸功率器件代工生產線。目前，本公司正在推進華虹無錫二期 12 英寸芯片生產線（華虹九廠）的建設。

如欲取得更多公司相關資料，請瀏覽：www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二三年 第二季度 (未經審核)	二零二二年 第二季度 (未經審核)	二零二三年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	631,381	620,823	630,842	1.7 %	0.1 %
毛利	175,056	208,870	202,197	(16.2)%	(13.4)%
毛利率	27.7 %	33.6 %	32.1 %	(5.9)	(4.4)
經營開支	(76,668)	(70,676)	(76,261)	8.5 %	0.5 %
其他(損失)/收入淨額	(54,709)	(56,675)	6,066	(3.5)%	(1,001.9)%
稅前溢利	43,679	81,519	132,002	(46.4)%	(66.9)%
所得稅(開支)/抵免	(35,845)	(28,272)	8,900	26.8 %	(502.8)%
期內溢利	7,834	53,247	140,902	(85.3)%	(94.4)%
淨利潤率	1.2 %	8.6 %	22.3 %	(7.4)	(21.1)
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	78,524	83,933	152,234	(6.4)%	(48.4)%
非控股權益	(70,690)	(30,686)	(11,332)	130.4 %	523.8 %
持有人應佔每股盈利					
基本	0.060	0.064	0.116	(6.3)%	(48.3)%
攤薄	0.060	0.064	0.115	(6.3)%	(47.8)%
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	1,074	1,036	1,001	3.7 %	7.3 %
產能利用率 ¹	102.7 %	109.7 %	103.5 %	(7.0)	(0.8)
淨資產收益率 ²	10.0 %	11.5 %	19.6 %	(1.5)	(9.6)

二零二三年第二季度

- 銷售收入達 6.314 億美元，同比上升 1.7%，環比持平。
- 毛利率 27.7%，同比下降 5.9 個百分點，主要由於平均銷售價格下降，折舊及動力成本上升，環比下降 4.4 個百分點，主要由於平均銷售價格下降。
- 經營開支 7,670 萬美元，同比上升 8.5%，主要由於研發工程片成本增加，環比持平。
- 其他損失淨額 5,470 萬美元，同比下降 3.5%，主要由於政府補貼及利息收入增加，部分被財務費用及外幣匯兌損失上升所抵消。上季度為其他收入 610 萬美元，主要由於本季度為大額外幣匯兌損失，而上季度為外幣匯兌收益。
- 所得稅開支 3,580 萬美元，同比上升 26.8%，主要由於應課稅利潤增加，上季度為所得稅抵免 890 萬美元，主要由於轉回上年度計提的代扣代繳股息稅。
- 期內溢利 780 萬美元，上年同期為 5,320 萬美元，上季度為 1.409 億美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 7,850 萬美元，上年同期為 8,390 萬美元，上季度為 1.522 億美元。
- 基本每股盈利 0.060 美元，上年同期為 0.064 美元，上季度為 0.116 美元。
- 淨資產收益率(年化) 10.0%，上年同期為 11.5%，上季度為 19.6%。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二三年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第二季度 % (未經審核)	二零二二年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	600,950	95.2 %	600,865	96.8 %	85	0.0 %
其他	30,431	4.8 %	19,958	3.2 %	10,473	52.5 %
銷售收入總額	631,381	100.0 %	620,823	100.0 %	10,558	1.7 %

- 本季度 95.2% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二三年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第二季度 % (未經審核)	二零二二年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	361,237	57.2 %	353,990	57.0 %	7,247	2.0 %
12 吋晶圓	270,144	42.8 %	266,833	43.0 %	3,311	1.2 %
銷售收入總額	631,381	100.0 %	620,823	100.0 %	10,558	1.7 %

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 3.612 億美元及 2.701 億美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二三年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第二季度 % (未經審核)	二零二二年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ³	489,269	77.5 %	450,449	72.6 %	38,820	8.6 %
北美 ⁴	48,547	7.7 %	73,213	11.8 %	(24,666)	(33.7)%
亞洲 ⁵	45,186	7.2 %	57,937	9.3 %	(12,751)	(22.0)%
歐洲	39,965	6.3 %	28,617	4.6 %	11,348	39.7 %
日本 ⁶	8,414	1.3 %	10,607	1.7 %	(2,193)	(20.7)%
銷售收入總額	631,381	100.0 %	620,823	100.0 %	10,558	1.7 %

- 本季度來自於中國的銷售收入 4.893 億美元，占銷售收入總額的 77.5%，同比增長 8.6%，主要得益於 IGBT、MCU 及超級結產品的需求增加，部分被 NOR flash、CIS 及其他電源管理的產品需求下降所抵消。
- 本季度來自於北美的銷售收入 4,850 萬美元，同比下降 33.7%，主要由於其他電源管理及 MCU 產品的需求減少。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 4,520 萬美元，同比下降 22.0%，主要由於邏輯、通用 MOSFET 及其他電源管理產品的需求減少。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 4,000 萬美元，同比增長 39.7%，主要得益於智能卡芯片及 IGBT 產品的需求增加。
- 本季度來自於日本的銷售收入 840 萬美元，同比下降 20.7%，主要由於 MCU 產品的需求減少。

³包括中國大陸及中國香港。

⁴包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁵不包括中國及日本。

⁶包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二三年	二零二三年	二零二二年	二零二二年	同比	同比
	第二季度 仟美元 (未經審核)	第二季度 % (未經審核)	第二季度 仟美元 (未經審核)	第二季度 % (未經審核)	仟美元	%
嵌入式非易失性存儲器	208,265	33.0 %	175,216	28.2 %	33,049	18.9 %
獨立式非易失性存儲器	33,360	5.3 %	69,595	11.2 %	(36,235)	(52.1)%
分立器件	251,351	39.8 %	188,933	30.5 %	62,418	33.0 %
邏輯及射頻	57,175	9.1 %	77,046	12.4 %	(19,871)	(25.8)%
模擬與電源管理	80,453	12.7 %	109,374	17.6 %	(28,921)	(26.4)%
其他	777	0.1 %	659	0.1 %	118	17.9 %
銷售收入總額	631,381	100.0 %	620,823	100.0 %	10,558	1.7 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 2.083 億美元，同比增長 18.9%，主要得益於 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入 3,340 萬美元，同比下降 52.1%，主要由於 NOR flash 產品的需求減少。
- 本季度分立器件銷售收入 2.514 億美元，同比增長 33.0%，主要得益於 IGBT 及超級結產品的需求增加。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 5,720 萬美元，同比下降 25.8%，主要由於 CIS 及邏輯產品的需求減少。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 8,050 萬美元，同比下降 26.4%，主要由於其他電源管理產品的需求減少。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二三年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第二季度 % (未經審核)	二零二二年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
55nm 及 65nm	84,920	13.5 %	114,320	18.4 %	(29,400)	(25.7)%
90nm 及 95nm	96,675	15.3 %	114,697	18.5 %	(18,022)	(15.7)%
0.11 μ m 及 0.13 μ m	120,254	19.0 %	104,371	16.8 %	15,883	15.2 %
0.15 μ m 及 0.18 μ m	37,368	5.9 %	47,290	7.6 %	(9,922)	(21.0)%
0.25 μ m	6,319	1.0 %	3,601	0.6 %	2,718	75.5 %
0.35 μ m 及以上	285,845	45.3 %	236,544	38.1 %	49,301	20.8 %
銷售收入總額	631,381	100.0 %	620,823	100.0 %	10,558	1.7 %

- 本季度 55nm 及 65nm 工藝技術節點的銷售收入 8,490 萬美元，同比下降 25.7%，主要由於 NOR flash、CIS 及邏輯產品的需求減少。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 9,670 萬美元，同比下降 15.7%，主要由於其他電源管理產品需求減少，部分被智能卡芯片及 MCU 產品的需求增加所抵消。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工藝技術節點的銷售收入 1.203 億美元，同比增長 15.2%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 3,740 萬美元，同比下降 21.0%，主要由於邏輯及 MCU 產品的需求減少。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 630 萬美元，同比增長 75.5%，主要得益於邏輯及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 2.858 億美元，同比增長 20.8%，主要得益於 IGBT 及超級結產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈 劃分的銷售收入	二零二三年	二零二三年	二零二二年	二零二二年	同比	同比
	第二季度	第二季度	第二季度	第二季度		
	仟美元	%	仟美元	%	仟美元	%
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)		
電子消費品	347,824	55.1 %	404,719	65.2 %	(56,895)	(14.1)%
工業及汽車	195,158	30.9 %	125,728	20.3 %	69,430	55.2 %
通訊	68,412	10.8 %	70,416	11.3 %	(2,004)	(2.8)%
計算機	19,987	3.2 %	19,960	3.2 %	27	0.1 %
銷售收入總額	631,381	100.0 %	620,823	100.0 %	10,558	1.7 %

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 3.478 億美元，占銷售收入總額的 55.1%，同比下降 14.1%，主要由於其他電源管理及 NOR flash 產品的需求下降，部分被超級結及 MCU 產品的需求增加所抵消。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 1.952 億美元，同比增長 55.2%，主要得益於 IGBT、智能卡芯片、通用 MOSFET 及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 6,840 萬美元，同比下降 2.8%，主要由於 CIS 產品需求減少，部分被模擬產品的需求增加所抵消。
- 本季度計算機產品銷售收入 2,000 萬美元，同比持平。

產能⁷及產能利用率

晶圓廠(折合 8 吋片晶圓)	二零二三年	二零二二年	二零二三年
	第二季度	第二季度	第一季度
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
產能 (200mm)	178	178	178
產能 (300mm)	75	65	65
合計產能	347	324	324
產能利用率 (200mm)	112.0%	110.0%	107.1%
產能利用率 (300mm)	92.9%	109.3%	99.0%
總體產能利用率	102.7%	109.7%	103.5%

- 本季度末月產能 347,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 102.7%。

⁷ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

折合 8 吋矽片晶圓	二零二三年 第二季度 (未經審核)	二零二二年 第二季度 (未經審核)	二零二三年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	1,074	1,036	1,001	3.7 %	7.3 %

- 本季度付運晶圓 1,074,000 片，同比上升 3.7%，環比上升 7.3%。

經營開支分析

以千美元計	二零二三年 第二季度 (未經審核)	二零二二年 第二季度 (未經審核)	二零二三年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,402	2,530	2,688	(5.1)%	(10.6)%
管理費用 ⁸	74,266	68,146	73,573	9.0 %	0.9 %
經營開支	76,668	70,676	76,261	8.5 %	0.5 %

- 經營開支 7,670 萬美元，同比上升 8.5%，主要由於研發工程片增加，環比持平。

其他(損失)/收入淨額

以千美元計	二零二三年 第二季度 (未經審核)	二零二二年 第二季度 (未經審核)	二零二三年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,921	3,852	3,464	1.8 %	13.2 %
利息收入	14,057	4,793	11,364	193.3 %	23.7 %
匯兌(損失)/收益	(62,646)	(56,555)	16,536	10.8 %	(478.8)%
分佔聯營公司溢利	1,984	444	1,520	346.8 %	30.5 %
財務費用	(28,287)	(8,194)	(28,413)	245.2 %	(0.4)%
政府補貼	14,213	496	788	2,765.5 %	1,703.7 %
其他	2,049	(1,511)	807	(235.6)%	153.9 %
其他(損失)/收入淨額	(54,709)	(56,675)	6,066	(3.5)%	(1,001.9)%

- 其他損失淨額 5,470 萬美元，同比下降 3.5%，主要由於政府補貼及利息收入增加，部分被財務費用及外幣匯兌損失上升所抵消。上季度為其他收入 610 萬美元，主要由於本季度為大額外幣匯兌損失，而上季度為外幣匯兌收益。

⁸管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以千美元計	二零二三年 第二季度 (未經審核)	二零二二年 第二季度 (未經審核)	二零二三年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	161,190	212,259	131,868	(24.1)%	22.2 %
投資活動所用現金流量淨額	(150,649)	(110,073)	(203,281)	36.9 %	(25.9)%
融資活動所(用)/得現金流量淨額	(300,183)	(30,087)	263,249	897.7 %	(214.0)%
外匯匯率變動影響淨額	(77,948)	(59,383)	17,946	31.3 %	(534.3)%
現金及現金等價物變動影響淨額	(367,590)	12,716	209,782	(2,990.8)%	(275.2)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 1.612 億美元，同比下降 24.1%，主要由客戶收款減少，部分被支付員工開支減少所抵消，環比上升 22.2%，主要由于上季度支付了獎金。
- 投資活動所用現金流量淨額 1.506 億美元，其中包括固定資產及無形資產投資支出 1.650 億美元，部分被收到利息收入 1,440 萬美元所抵消。
- 融資活動所用現金流量淨額 3.002 億美元，其中新增質押保證金 1.677 億美元，償還銀行貸款本金 8,560 萬美元，支付利息 5,270 萬美元，支付租賃負債 330 萬美元，及支付上市費用 40 萬美元，部分被提取銀行借款 810 萬美元及發行股份收到 140 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於六月三十日 二零二三年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二三年 (未經審核)
資產總額	6,950,336	7,378,331
負債總額	2,555,160	2,747,651
所有者權益總額	4,395,176	4,630,680
資產負債率 ⁹	36.8%	37.2%

資本開支

以千美元計	二零二三年 第二季度 (未經審核)	二零二三年 第一季度 (未經審核)
華虹 8 吋	16,677	25,642
華虹無錫	148,289	190,978
合計	164,966	216,620

- 本季度資本開支 1.650 億美元，其中 1.483 億美元用於華虹無錫。

⁹資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於六月三十日 二零二三年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二三年 (未經審核)
發展中物業	143,674	143,960
存貨	558,252	593,922
貿易應收款項及應收票據	310,705	306,062
預付款項、其他應收款項及其他資產	32,194	38,657
應收關聯方款項	16,803	15,348
已凍結存款及定期存款	167,077	1,056
現金及現金等價物	1,850,957	2,218,547
流動資產總額	3,079,662	3,317,552
貿易應付款項	227,907	220,243
其他應付款項及暫估費用	397,826	441,795
計息銀行借款	385,746	408,669
租賃負債	4,477	5,582
政府補助	34,133	38,165
應付關聯方款項	4,720	7,944
應付所得稅	49,557	98,314
流動負債總額	1,104,366	1,220,712
淨營運資金	1,975,296	2,096,840
速動比率	2.2x	2.1x
流動比率	2.8x	2.7x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	45	43
存貨周轉天數	114	123

- 存貨由上季度末的 5.939 億美元下降至本季度末的 5.583 億美元，主要由於在製品及產成品的減少。
- 已凍結存款及定期存款由上季度末的 110 萬美元上升至本季度末的 1.671 億美元，主要由於新增質押保證金。
- 現金及現金等價物由上季度末的 22.185 億美元下降至本季度末的 18.510 億美元，主要由於前述現金流量分析中闡述的原因。
- 其他應付款項及暫估費用由上季度末的 4.418 億美元下降至本季度末的 3.978 億美元，主要由於客戶預收款減少，部分被應付職工薪酬增加所抵消。
- 應付所得稅由上季度末的 9,830 萬美元下降至本季度末的 4,960 萬美元，主要由於本季度支付了 2022 年度所得稅，部分被本季度計提所得稅開支所抵消。
- 淨營運資金 本季度末 19.753 億美元，流動比率 2.8。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數 45 天。
- 存貨周轉天數 114 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日 二零二三年 (未經審核)	於六月三十日 二零二二年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二三年 (未經審核)
銷售收入	631,381	620,823	630,842
銷售成本	(456,325)	(411,953)	(428,645)
毛利	175,056	208,870	202,197
其他收入及收益	34,245	9,441	32,970
銷售及分銷費用	(2,402)	(2,530)	(2,688)
管理費用	(74,266)	(68,146)	(73,573)
其他費用	(62,651)	(58,366)	(11)
財務費用	(28,287)	(8,194)	(28,413)
分佔聯營公司溢利	1,984	444	1,520
稅前溢利	43,679	81,519	132,002
所得稅(開支)/抵免	(35,845)	(28,272)	8,900
期內溢利	7,834	53,247	140,902
以下各方應佔利潤			
母公司擁有人	78,524	83,933	152,234
非控股權益	(70,690)	(30,686)	(11,332)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.060	0.064	0.116
攤薄	0.060	0.064	0.115
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,308,028,146	1,301,760,320	1,307,286,436
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,318,619,081	1,316,099,219	1,318,907,456

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於六月三十日 二零二三年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二三年 (未經審核)	於六月三十日 二零二二年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	3,256,562	3,436,656	2,955,516
投資物業	163,241	171,653	175,337
使用權資產	80,145	84,063	81,994
無形資產	31,170	31,217	31,516
於聯營公司的投資	129,414	134,017	118,129
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	151,812	181,597	221,072
長期預付款項	40,937	6,903	24,890
遞延稅項資產	17,393	14,673	9,965
非流動資產總額	3,870,674	4,060,779	3,618,419
流動資產			
發展中物業	143,674	143,960	121,026
存貨	558,252	593,922	473,935
貿易應收款項及應收票據	310,705	306,062	241,967
預付款項、其他應收款項及其他資產	32,194	38,657	63,186
應收關聯方款項	16,803	15,348	14,212
已凍結存款及定期存款	167,077	1,056	349
現金及現金等價物	1,850,957	2,218,547	1,707,650
流動資產總額	3,079,662	3,317,552	2,622,325
流動負債			
貿易應付款項	227,907	220,243	303,263
其他應付款項及暫估費用	397,826	441,795	575,171
計息銀行借款	385,746	408,669	231,334
租賃負債	4,477	5,582	3,309
政府補助	34,133	38,165	66,876
應付關聯方款項	4,720	7,944	15,630
應付所得稅	49,557	98,314	35,532
流動負債總額	1,104,366	1,220,712	1,231,115
流動資產淨額	1,975,296	2,096,840	1,391,210
總資產減流動負債	5,845,970	6,157,619	5,009,629
非流動負債			
計息銀行借款	1,410,544	1,496,396	1,346,974
租賃負債	18,312	19,080	15,687
遞延稅項負債	21,938	11,463	15,102
非流動負債總額	1,450,794	1,526,939	1,377,763
淨資產	4,395,176	4,630,680	3,631,866
權益和負債權益			
股本	1,997,829	1,996,528	1,987,494
儲備	1,130,367	1,229,318	901,446
本公司擁有人應佔權益	3,128,196	3,225,846	2,888,940
非控股權益	1,266,980	1,404,834	742,926
權益總額	4,395,176	4,630,680	3,631,866

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日 二零二三年 (未經審核)	於六月三十日 二零二二年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二三年 (未經審核)
經營活動所得現金流量：			
稅前溢利	43,679	81,519	132,002
折舊及攤銷	123,661	115,358	120,338
應佔聯營公司溢利	(1,984)	(444)	(1,520)
營運資金的變動及其它	(4,166)	15,826	(118,952)
經營活動所得現金流量淨額	161,190	212,259	131,868
投資活動所用現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(164,966)	(112,353)	(216,620)
其他投資活動所得現金流量	14,317	2,280	13,339
投資活動所用現金流量淨額	(150,649)	(110,073)	(203,281)
融資活動所得現金流量：			
非控股權益資本注資	-	-	296,197
提取銀行貸款	8,116	36,971	12,972
發行股份所得收益	1,407	393	1,442
受限制貨幣資金增加	(167,738)	-	-
償還銀行貸款	(85,565)	(54,465)	(42,527)
償還租賃負債	(3,320)	(545)	(756)
已付利息	(52,720)	(12,441)	(3,830)
其他融資活動所用現金流量	(363)	-	(249)
融資活動所(用)/得現金流量淨額	(300,183)	(30,087)	263,249
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(289,642)	72,099	191,836
外匯匯率變動影響淨額	(77,948)	(59,383)	17,946
期初現金及現金等價物	2,218,547	1,694,934	2,008,765
期末現金及現金等價物	1,850,957	1,707,650	2,218,547

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事

孫國棟

王靖

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二三年八月十日